

# Servizio Elettronica

**Previsione attività 2026**

**Flavio Loddo**

## Composizione personale nel 2026:

- Francesco Maiorano
- Matteo Rizzi

# Richieste DOT1

Sigla	Descrizione attività	Richiesta (MP)	Assegn. proposta (MP)	Priority
LHCb	Progettazione PCB scheda test FATIC4	0.5	1	1
LHCb	Montaggio scheda test FATIC4	0.5	0.5	1
LHCb	Progettazione PCB scheda FE FATIC4	1.5	1.5	1
LHCb	Progettazione PCB scheda concentratore FE -> MOSAIC	1	1	1
CMS (RPC)	Assistenza su elettronica di lettura camere	1	1	1
CMS (GEM)	Modifica dell'elettronica dello stack di ME0 al CERN	2	2	1
CMS (GEM)	Assemblaggio dei moduli ME0 con saldature SMD	1	0.5	1
CMS (TRK)	Assistenza su elettronica di lettura moduli	1	0.5	2
CMS (TRK)	Ricezione e test cavi al CERN	1	1	1
RD_MUCOL / INCANTO	Realizzazione di adattatori/cavi per i moduli FERS della CAEN o per testboard di ASIC della linea ROC. Supporto test FATIC3	1	1	1
RD_FCC	Supporto per test di componenti elettronici per prototipi di camere/tubi a drift	1	1	1
Hyper-K	Supporto installazione strumentazione e cavi in laboratorio Bari	0.5	0.5	1
Totale DOT1		12	11.5	

Tipologia	Alta priorità	Bassa priorità	Totale
Progettaz. PCB	3.5	0	3.5
Supporto lab.	7.5	0.5	8

# Richieste DOT2

Sigla	Descrizione attività	Richiesta (MP)	Assegn. proposta (MP)	Priority
CTA	Progettazione e disegno di PCB per SMART3	2	0 (2025)	
CTA	Test cluster LST CTA+ (BA) e installazione e test sulla camera (CT)	4	2	2
CTA	Progettazione e disegno di PCB per caratterizzazione SiPM con TSV (CTA+) con SMART	2	2	1
CTA	<i>Progettazione e test di elettronica a larga banda per telescopi CTA++ (S.J. Approvazione PON)</i>	2	2	2
HERD_DMP	Assemblaggi per attività di test in laboratorio	1	1	1
NUSES	<i>Eventuale</i> re-work SiPM carrier board fibre	0.5	0.5	2
SpaceltUp - ASI	<i>Realizzazione PCB per ASIC LowPower (NON C'E' L'ASIC)</i>	0.5	0.5	2
SpaceltUp - ASI	Attività di montaggio schede elettroniche per ASIC LowPower (NON C'E' L'ASIC)	1	1	2
ADAPT	Assemblaggio elettronico tile ACD di Volo	2	2	1
ADAPT	<i>Progettazione e testing Board di interfaccia per simulare connessione end to end</i>	2	2	1
KM3NeT	Supporto attività di integrazione e prototipazione	1	1	1
Totale DOT2		18	14	

Tipologia	Alta priorità	Bassa priorità	Totale
Progettaz. PCB	4	2.5	6.5
Supporto lab.	4	3.5	7.5

# Richieste DOT3

Sigla	Descrizione attività	Richiesta (MP)	Assegn. proposta (MP)	Priority
ALICE (ITS3)	Supporto set-up baby-Mosaix	0.5	<b>0.5</b>	1
ePic-SVT	Implementazione dissipatore termico per mockup finalizzato a studi termici di prototipi L0-L1 SVT	0.5	<b>0.5</b>	1
ALICE (RICH)	progettazione della scheda per il prototipo del modulo del rivelatore e modifiche delle attuali schede con l'ASIC DENEb 1024 pixel per ALICE3	2	<b>2</b>	1
Totale DOT3		3	<b>3</b>	

Tipologia	Alta priorità	Bassa priorità	Totale
Progettaz. PCB	2	0	2
Supporto lab.	1	0	1

# Richieste DOT5

Sigla	Descrizione attività	Richiesta (MP)	Assegn. proposta (MP)	Priority
SHINE	Supporto installazione setup sperimentali	0.5	<b>0.5</b>	1
ASPIDES	Progettazione di PCB per caratterizzazione prototipo CMOS-SPAD	1	<b>1</b>	1
QUERIS	Supporto modifica apparato sicurezza laser	0.5	<b>0.5</b>	1
Totale DOT5		2	<b>2</b>	

Tipologia	Alta priorità	Bassa priorità	Totale
Progettaz. PCB	1	0	1
Supporto lab.	1	0	1

- **Attività 2026**
  - Richieste iniziali: 35 MP
  - Assegnazione: 30.5 MP (13 MP per progettazione PCB; 17.5 MP per attività di laboratorio)
    - 24 Alta Priorità
    - 6.5 Bassa Priorità
- Disponibilità 24 MP (netta: 21 MP)